(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2007 年1 月18 日 (18.01.2007)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2007/007532 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/683 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2006/312686

(22) 国際出願日: 2006 年6 月26 日 (26.06.2006)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2005-198807 2005 年7 月7 日 (07.07.2005) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): リンテック株式会社 (LINTEC CORPORATION) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 野中英明 (NONAKA, Hideaki) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP). 小林賢治 (KOBAYASHI, Kenji) [JP/JP]; 〒1730001 東京都板橋区本町２３－２３ リンテック株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 山口義雄 (YAMAGUCHI, Yoshio); 〒2060034 東京都多摩市鶴牧１丁目４番１７号 いずみビル８Ｆ Tokyo (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

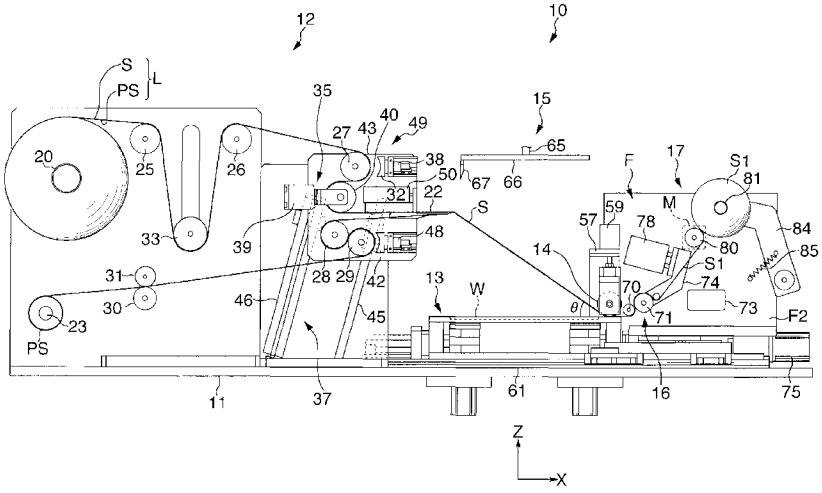
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

[続葉有]

(54) **Title:** SHEET ADHERING APPARATUS

(54) 発明の名称: シート貼付装置



(57) **Abstract:** A sheet adhering apparatus is provided with a sheet feeding unit (12) which includes a peel plate (22) for peeling an adhesive sheet (S) from a peeling sheet (PS), and a pressing roller (14) for pressing and adhering the adhesive sheet (S) to the wafer (W) supported by a table (13). The peel plate (22) is supported to move forward and backward by means of a cylinder (50). The initial position of the leading end of the peel plate (22) is adjusted to the front and rear in accordance with the size of the wafer (W) or the size of the table (13) which supports the wafer (W).

[続葉有]

WO 2007/007532 A1

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

剥離シート（ＰＳ）から接着シート（Ｓ）を剥離するピールプレート（２２）を含むシート繰出ユニット（１２）と、テーブル（１３）に支持されたウエハ（W）に前記接着シート（Ｓ）を押圧して貼付する押圧ローラ（１４）とを備え、前記ピールプレート（２２）は、シリンダ（５０）を介して進退可能に支持されている。このピールプレート（２２）は、ウエハ（W）の大きさ若しくはこれを支持するテーブル（１３）の大きさに応じて先端の初期位置が前後に調整されるようになっている。